

第三代半导体 SiC 晶体生长及晶圆加工技术研讨会

当前，碳化硅 (SiC) 作为第三代半导体核心材料，在新能源汽车、光伏储能、5G 通信、特高压、大数据中心等新基建领域快速渗透，已成为全球半导体产业的前沿制高点。我国“十四五”规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域，但与国际先进水平相比，在晶体缺陷控制、生长速率提升、加工精度优化、良品率改善等关键技术环节仍存在差距，亟需通过产学研协同破解难题。

为加快推动我国 SiC 产业技术突破与成果转化，中国粉体网定于 2026 年 5 月 28 日在安徽合肥举办“第三代半导体 SiC 晶体生长及晶圆加工技术研讨会”，汇聚行业专家、学者及企业代表共探技术路径与产业机遇。

在此背景下，**先进半导体晶体材料**将于**2026年5月28日**在**安徽·合肥**举办**第三届第三代半导体SiC晶体生长及晶圆加工技术研讨会**，大会将汇聚国内行业专家、学者、技术人员、企业界代表围绕晶体生长工艺、关键原材料、生长设备及应用、碳化硅晶片切、磨、抛技术等方面展开演讲交流。

会议时间：

2026年5月28日

会议地点：

安徽·合肥

主办单位：



会议主题：

- 1、碳化硅半导体产业现状、政策导向与未来市场展望
- 2、大尺寸（8英寸及以上）SiC 晶体生长技术难点及突破路径
- 3、SiC 单晶生长用高纯碳粉与硅粉的纯度控制（杂质去除）及制备工艺

- 4、碳化硅晶体生长装备（长晶炉）关键部件（保温层、加热系统）应用进展
- 5、碳化硅衬底研磨 / 抛光工艺优化及专用耗材（磨料、抛光液）技术创新
- 6、SiC/TaC 涂层制备工艺及其在晶体生长设备中的应用性能
- 7、第三代半导体碳化硅的先进切割技术（机械切割、等离子切割）对比
- 8、激光技术（3D 激光隐切、飞秒激光）在碳化硅切割及划片上的应用与损耗控制
- 9、高平整度 SiC 衬底化学机械抛光（CMP）技术研究与良率提升
- 10、8 英寸碳化硅外延材料生长核心工艺（温度、压力控制）与关键装备选型
- 11、碳化硅衬底及外延层缺陷（微管、位错）检测技术与自动化设备应用
- 12、碳化硅晶片清洗工艺（超声清洗、化学清洗）与表面洁净度控制
- 13、SiC 晶体加工关键设备（抛光机、检测设备）国产化进程与性能对标
- 14、晶圆切割设备市场现状、技术趋势及国产替代案例分析
- 15、立方 SiC 单晶液相法生长的界面稳定性与晶体质量调控
- 16、车规级 SiC 晶圆可靠性测试（AEC-Q102 认证）适配技术
- 17、SiC 晶体生长“黑匣子”状态实时监测（温度、压力传感器）系统开发
- 18、碳化硅全产业链供应链（材料 - 设备 - 加工 - 应用）协同整合模式

参会对象：

- 半导体材料领域科研机构（高校、中科院研究所）专家、学者及研究生
- SiC 晶体生长、衬底制备、晶圆加工企业的技术负责人、研发工程师、生产管理人员
- 高纯碳粉与硅粉、晶体生长设备、切割 / 抛光设备及耗材（磨料、抛光液）供应商代表
- 新能源汽车、光伏逆变器、5G 基站、储能系统等下游应用企业的研发、采购负责人
- 政府相关主管部门（工信、科技系统）、产业园区、投资机构及行业协会相关人员

往届嘉宾阵容：

SIC-3 2026/05/28
安徽·合肥

第三代半导体SiC晶体生长 及晶圆加工技术研讨会

往届嘉宾阵容

 史冬梅 研究员、副总技术 国家自然科学基金委员会 高新技术研发发展中心	 刘晓星 市场经理 山西烁科晶体 有限公司	 俞宝清 总经理兼技术总监 宁波兰辰光电有限公司	 修向前 教授 南京大学	 赵聪 研发经理 杭州晶驰机电 有限公司	 刘福超 联合创始人&副总经理 青禾晶元半导体科技 集团)有限责任公司	 王巍 销售副总 河北同光半导体 股份有限公司
 陆敏 总经理 常州臻晶半导体 有限公司	 张泽芳 博士、总经理 浙江博来纳润 电子材料有限公司	 陈雪江 副教授 西安交通大学能源 与动力工程学院	 周骏峰 高级市场经理 安徽芯塔电子科 技有限公司	 明亮 产品经理 国家自然科学基金委 员会高新技术研究发展	 周立勋 总经理 长春光光精密复 合材料有限公司	 宋宝山 总经理 江苏晶孚新材料 科技有限公司

现场风采



联系方式
段经理：138 1044 5572

报名专属通道 >



特色活动：

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购, 工艺方案等需求进行现场采配活动, 相关信息将进行展板展示, 提高现场沟通交流效率!

征集内容包含但不限于以下几点：

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

大会赞助：

(赞助详细内容请联系会务组了解)

- 1、协办赞助 (含展位、企业致辞, LED 大屏广告, 视频播放, 企业报告等)
- 2、晚宴赞助 (含展位、晚宴大屏 LOGO 展示、晚宴致辞、主持人口播广告等)
- 3、其它赞助 (资料袋、茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等)
- 4、展位展示 (展示桌椅+展位背景墙广告)

同期活动：

展览展示

费用 10000 元

- 1、标准展桌一套(配 2 把椅子)
- 2、企业喷绘背景墙广告 1 个 (2 米宽*2.6 米高)
- 3、参会名额 2 人

会议费用：

付款时间	费用
3月1日前	1500/人
5月1日前	2000/人
5月1日后	2500/人

付款账户：

户名	山东中粉网信息技术有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司临沂沂州支行
帐号	37050182640100001790

会务组：

联系人：段湾湾

联系方式：13810445572 (微信)

邮箱：duanwanwan@cnpowder.com

